

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2025-108

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

## 闻泰科技股份有限公司

### 关于担保实施进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“闻泰科技”）全资子公司安世半导体（中国）有限公司（以下简称“安世中国”）、安世半导体（无锡）有限公司（以下简称“安世无锡”）、安世半导体（上海）有限公司（以下简称“安世上海”）、安世半导体科技（上海）有限公司（以下简称“安世科技”）、安泰可技术（无锡）有限公司（以下简称“安泰可无锡”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 5 月公司及子公司为上述被担保人合计提供的担保金额为 0.36 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额合计为 0.36 亿元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：2025 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保情况

2025 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 103 亿元，均为对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公司担保额度。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保。

2025 年 5 月，在年度预计担保额度范围内担保实施情况如下：

| 担保方           | 被担保方                      | 已审议担保额度 | 协议签署日期    | 本次担保金额     | 债权人名称        | 担保方式      | 担保期限                  | 担保原因及范围  | 是否有反担保 |
|---------------|---------------------------|---------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|--------|
| Nexperia B.V. | 安世无锡、安世上海、安世中国、安世科技、安泰可无锡 | 10 亿元   | 2025-5-31 | 合计 0.36 亿元 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 最高额连带责任担保 | 2025-5-31 至 2030-5-30 | 企业日常经营周转 | 否      |

注：公司全资子公司 Nexperia B.V.为安世无锡、安世上海、安世中国、安世科技、安泰可无锡提供总金额 500 万美元的担保，由前述 5 家子公司共享。表中按照中国外汇交易中心披露的 2025 年 5 月 30 日人民币汇率中间价 7.1848 计算约折合人民币 0.36 亿元。

本次担保前被担保方安世无锡、安世上海、安世中国、安世科技、安泰可无锡的担保余额为 0 亿元。本次担保后被担保方安世无锡、安世上海、安世中国、安世科技、安泰可无锡的担保余额为 0.36 亿元，可用担保额度为 9.64 亿元。

（二）担保事项履行的决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》。2025 年 5 月 16 日，该议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见《第十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临 2025-055）、《关于 2025 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2025-058）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-073）。

公司本次提供的担保金额在 2024 年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况

公司半导体业务 2024 年度实现营业收入 147.15 亿元，业务毛利率 37.47%，实现净利润 22.97 亿元；2025 年第一季度实现收入 37.11 亿元，同比增长 8.40%，业务毛利率为 38.32%，净利润 5.78 亿元。本次被担保子公司具体情况如下：

（一）安世半导体（中国）有限公司

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 91441900719388499E |
| 法定代表人    | 文德景                |
| 注册资本     | 17400万美元           |
| 成立日期     | 2000-01-28         |
| 注册地址     | 东莞市黄江镇田美工业园北区      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要股东 | 公司100%持股                                                                                                                                                                                                                        |
| 经营范围 | 研究、设计、开发和测试半导体技术软件、集成电路、电子元配件、系统级封装技术及其应用材料和其他电子产品；生产和销售半导体、新型电子元器件：片式元器件（微小型表面贴装元器件：片式二极管、片式三极管）；销售自产产品，研发成果转让，上述产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关的技术咨询、技术服务、售后服务、设备保养及维护管理服务、仓储服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

截止 2024 年 12 月 31 日，安世半导体（中国）有限公司资产总额 45.02 亿元，负债总额 20.84 亿元，净资产 24.18 亿元；2024 年度营业收入 35.80 亿元，净利润 0.57 亿元。

截止 2025 年 3 月 31 日，安世半导体（中国）有限公司资产总额 43.60 亿元，负债总额 22.40 亿元，净资产 21.19 亿元；2025 年一季度营业收入 9.16 亿元，净利润-0.14 亿元（未经审计）。

（二）安世半导体（无锡）有限公司

|          |                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91320214MA7KLQT328                                                                                                                                                                            |
| 法定代表人    | WONG KIM JOO                                                                                                                                                                                  |
| 注册资本     | 10000万美元                                                                                                                                                                                      |
| 成立日期     | 2022-03-08                                                                                                                                                                                    |
| 注册地址     | 无锡市新吴区鸿昌路31号                                                                                                                                                                                  |
| 主要股东     | 公司持股100%                                                                                                                                                                                      |
| 经营范围     | 一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

截止 2024 年 12 月 31 日，安世半导体（无锡）有限公司资产总额 1.60 亿元，负债总额 1.53 亿元，净资产 0.07 亿元；2024 年度营业收入 0.06 亿元，净利润-0.43 亿元。

截止 2025 年 3 月 31 日，安世半导体（无锡）有限公司资产总额 1.64 亿元，

负债总额 1.67 亿元，净资产-0.03 亿元；2025 年一季度营业收入 0.01 亿元，净利润-0.11 亿元（未经审计）。

（三）安世半导体（上海）有限公司

|          |                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FPJFN48                                                                                                                                                              |
| 法定代表人    | 文德景                                                                                                                                                                             |
| 注册资本     | 100万元人民币                                                                                                                                                                        |
| 成立日期     | 2020-08-20                                                                                                                                                                      |
| 注册地址     | 上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H604室                                                                                                                                                     |
| 主要股东     | 公司持股100%                                                                                                                                                                        |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；电子产品销售；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

截止 2024 年 12 月 31 日，安世半导体（上海）有限公司资产总额 1.43 亿元，负债总额 1.17 亿元，净资产 0.26 亿元；2024 年度营业收入 3.58 亿元，净利润 0.1 亿元。

截止 2025 年 3 月 31 日，安世半导体（上海）有限公司资产总额 1.46 亿元，负债总额 1.21 亿元，净资产 0.25 亿元；2025 年一季度营业收入 0.79 亿元，净利润 0 亿元（未经审计）。

（四）安世半导体科技（上海）有限公司

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FPLET2Y                                                                  |
| 法定代表人    | 高天维                                                                                 |
| 注册资本     | 10000万美元                                                                            |
| 成立日期     | 2021-04-02                                                                          |
| 注册地址     | 上海市黄浦区局门路436号5号楼（产权幢号为8幢）2层201室                                                     |
| 主要股东     | 公司持股100%                                                                            |
| 经营范围     | 一般项目：半导体、集成电路、电子元器件和其他电子产品领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术交流、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）； |

|  |                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 半导体、电子元器件、电子产品的零售、批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，仓储服务（除危险品）。<br>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

截止 2024 年 12 月 31 日，安世半导体科技（上海）有限公司资产总额 4.21 亿元，负债总额 1.38 亿元，净资产 2.84 亿元；2024 年度营业收入 3.72 亿元，净利润 0.18 亿元。

截止 2025 年 3 月 31 日，安世半导体科技（上海）有限公司资产总额 4.31 亿元，负债总额 1.38 亿元，净资产 2.93 亿元；2025 年一季度营业收入 1.02 亿元，净利润 0.04 亿元（未经审计）。

（五）安泰可技术（无锡）有限公司

|          |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 统一社会信用代码 | 91320214MA7LYL28XU                                                                                              |
| 法定代表人    | 胡振辉                                                                                                             |
| 注册资本     | 500万美元                                                                                                          |
| 成立日期     | 2022-03-28                                                                                                      |
| 注册地址     | 无锡市新吴区和风路汇融广场A栋512室                                                                                             |
| 主要股东     | 公司持股100%                                                                                                        |
| 经营范围     | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

截止 2024 年 12 月 31 日，安泰可技术（无锡）有限公司资产总额 0.33 亿元，负债总额 0.14 亿元，净资产 0.19 亿元；2024 年度营业收入 0.03 亿元，净利润-0.02 亿元。

截止 2025 年 3 月 31 日，安泰可技术（无锡）有限公司资产总额 0.62 亿元，负债总额 0.44 亿元，净资产 0.18 亿元；2025 年一季度营业收入 0.03 亿元，净利润-0.02 亿元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司与金融机构签署的担保协议，其主要内容如下：

担保方：Nexperia B.V.

被担保人：安世半导体（中国）有限公司、安世半导体（无锡）有限公司、安世半导体（上海）有限公司、安世半导体科技（上海）有限公司、安泰可技术（无锡）有限公司

债权人：汇丰银行（中国）有限公司

担保方式：最高额连带责任担保

担保金额：500 万美元（折合约 0.36 亿元人民币）

保证期间：2025 年 5 月 31 日至 2030 年 5 月 30 日

上述担保无反担保，被担保方均为公司全资子公司，无其他股东方。

#### **四、担保的必要性和合理性**

公司为子公司提供担保，是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。各子公司经营稳定，资信良好，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险，符合公司整体利益。

#### **五、董事会意见**

本次担保系公司股东大会审议通过的担保额度内发生。公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保人具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于被担保人开展融资活动，保障公司利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额 103 亿元，均为公司及其子公司对子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 29.97%，无逾期担保。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十一日